

定制软硬结合板多层板PCB FPCB沉金刚挠结合板电路板

产品名称	定制软硬结合板多层板PCB FPCB沉金刚挠结合板电路板
公司名称	领智电路(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	PCB:软硬结合板 FPCB:刚挠结合板 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边学子围巨基 工业园D栋三楼
联系电话	0755-26395768 13828799508

产品详情

软硬结合板的分类若是依制程分类，软板与硬板接合的方式，可区分为软硬复合板与软硬结合板两大类产品，差别在于软硬复合板的技术，可于制程中将软板和硬板组合，其中，有共通的盲孔和埋孔设计，因此可以有更高密度的电路设计，而软硬结合板的技术，则是软板和硬板分开制作后再行压合成单一片电路板，有讯号连接但无贯通孔的设计。但目前惯用”软硬结合板”统称全部的软硬结合板产品，而不细分两者。

软硬结合板的物理特性

软硬结合板在材料、设备与制程上，与原先软板、硬板各有差异。在材料方面，硬板的材质是PCB的FR4之类的材质，软板的材质是PI或是PET类的材质，两材料之间有接合、热压收缩率不同等的问题，对于产品的稳定度而言是困难点，而且软硬结合板因为立体空间配置的特性，除XY轴面方向应力的考量，Z轴方向应力承受也是重要的考量，目前有材料供货商对PCB硬板或软板厂商，提供软硬结合板适用的改良型材料，如环氧树脂（Epoxy）或是改良型树脂（Resin）等材料，以符合PCB硬板或软板间的接合问题。在设备方面，软硬结合板因为材料特性与产品规格的差异，在压合与镀铜部份的设备必需作修正，设备的适用程度将影响产品良率与稳定度，因此跨入软硬结合板的生产前须先考虑到设备的适用程度。

二、生产流程(全流程)

1. FPC生产流程: 开料 钻孔 PTH 电镀 前处理 贴干膜 对位 曝光 显影

图形电镀 脱膜 前处理 贴干膜 对位曝光 显影 蚀刻

脱膜 表面处理 贴覆盖膜 压制 固化 沉镍金 印字符

剪切 电测 冲切 终检 包装 出货

2.单面板制程: 开料 钻孔 贴干膜 对位 曝光 显影 蚀刻

脱膜 表面处理 贴覆盖膜 压制 固化 表面处理 沉镍金

印字符 剪切 电测 冲切 终检 包装 出货

领智电路专注各类软硬结合板pcb加工定制，官方认证网站：www.lzdlpcb.com